

制定	2005.1.08	Solder YTB101	代号	YTB101
修订			页次	共 5 页第 1 页
发送			版本	1

1、 适用范围 Application

本产品适用于电子零件和电器焊接无铅焊锡条。

The product is lead free solder bar, used in electronics parts and Electrical appliawe.

2、 化学成分 The chemical composition

2.1 主要化学成分 Main ingredient

主要成分 Main ingredient(wt%)		
Cu	RE	Sn
0.7(±0.2)	微量	余量 Balance

2.2 杂质成分 Impurity of solder alloy

杂质成分不大于 Impurity of solder alloy(wt%) Max									
Pb	Sb	Bi	P	Fe	Al	Zn	As	In	Cd
0.03	0.05	0.1	0.003	0.02	0.001	0.001	0.03	0.05	0.002

3、 形状、尺寸、重量及允许偏差 Form, Diameter ,Weight and Tolerance

形状 Form	尺寸及允许偏差(mm) Dimension and Tolerance			重量 Weight
条状 Bar	长 <b>Length</b>	335.0	±6.0	0.5Kg/根
	宽 <b>Width</b>	18.0	±2.5	0.5Kg/Pc
	高 <b>Height</b>	10.0	±1.5	

制定	2005.01.08	Solder YTB101	代号	YTB101
修订			页次	共 5 页第 2 页
发送			版本	1

4、 物理性能（参考值） Physical Property of solder alloy（Reference Value）

熔融温度范围 Melting Point	比重 Specific Gravity	抗拉强度 Tensile Strength	延伸率 Elongation
227 °C	7.4±0.2	50Mpa	38%

5、 外观 Appearance

5.1 表面应该光滑、清洁、无异物附着。

The surface of material shall be smooth and glossy clean. Adhesion of foreign matters and dirt shall not be found.

5.2 表面应该无裂缝以及划痕。

Significant scratches、cracks、tears and shall not be found.

6、 重量和包装 Unit mass and Packaging

包装 Packaging			
名称 Type		净重 N.W/CTN	毛重 G.W/CTN
瓦楞纸箱 corrugated box		20KG±100g	20.3KG±100g

制定	2005.01.08	Solder YTB101	代号	YTB101
修订			页次	共 5 页第 3 页
发送			版本	1

7、 标识 Marking

YT-----生产厂 B-----锡条 101----- (Sn0.7CuRE)

瓦楞纸箱上包括品名、批号、生产日期、净重、毛重、制造者。

The product name、net weight、gross weight、lot No、date and manufacturer's name is marked on the box.

8、 质量保证期 Guarantee period

从制造日起 2 年内，为该产品的质量保证期。

The guarantee period of this product shall be two years from the manufacturing date.

9、 检测方法 Test methods

9.1 外观 Appearance

参照 GB/T 8012-2000 中 4.3 条款，以目视检查。

Refer to the clause 4.3of standard GB/T8012-2000 and inspect by visual observation.

9.2 化学成分 Chemical Composition of solder

用化学分析法（参照 GB/T3260-2000 的相关要求）分析主要成分，杂质含量按欧洲标准（EN29453）要求执行。

The Chemical composition of material is fulfilled according to the standard GB/T3260-2000.Impurity limit is according to the standard EN-29453.

制定	2005.01.08	Solder YTB101	代号	YTB101
修订			页次	共 5 页第 4 页
发送			版本	1

10. 品质保证体系流程框架图 Flow Chart for Quality Guarantee  
 进料检验（本公司质检科）→炉中成分检验→表面处理检验（锡条）  
 →包装检查→成品检验→出货抽检  
 Material Inspection（Our QA Department）→Composition Inspection（In The Stove）→Surface Treatment Inspection（Solder Bar）→Package Inspection→Finished Produce Inspection→Shipment Choice Inspection
11. 每批产品出具《产品质量证明书》。包括：名称、牌号、代号、化学成分等。  
 Every lot product must provide quality coertificate, which includes Product name, code, number, chemical composition.
12. 原材料产地

原材料名称	产地
锡（Sn）	云南（云南锡业公司和自立矿冶公司）
铜（Cu）	浙江（富春江冶炼厂）

#### Original of Raw Material

Name of Raw Material	Original
Tin（Sn）	Yunnan (Yunnan Tin Co.,Ltd. And Gejiu Zili Mining and Smelting Co.,Ltd.)
Copper（Cu）	Zhejiang（Fuchunjiang Mining Co.,Ltd.）

制定	2005.01.08	Solder YTB101	代号	YTB101
修订			页次	共 5 页第 5 页
发送			版本	1

13. 检测设备 Inspection equipment

检验设备名称 Equipment Name	产地 Original	型号规格 Model	数量 Number	出厂年份 ManuFature Date
原子吸收分光仪 Atom absorption spectrometry	上海安捷伦	3510	1	2001
电光分析天平 Electronic optical analytical balance	上海天平仪器 厂	TG328A	3	1999
电子天平 Electronic balance	上海天平仪器 厂	MP2000-2	1	1998
电导率仪 Conductivity	上海雷磁	DDS-11A	1	1998
绝缘电阻仪 Insulance meter	南通电子仪器 厂	NF2511A	1	1998
分光光度计 spectrometer	上海航空	721	1	2002
可焊性测试仪 solder checker	上海长江	SKC-8H	1	2005
视频金相显微镜 Video metallurgical microscope	南京	XD--2	1	2005